

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-24

## 天津中环半导体股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周红	独立董事	因公出差	毕晓方

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,785,156,473 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	中环股份	股票代码	002129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦世龙	蒋缘	
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号	
电话	022-23789787	022-23789787	

电子信箱	qinshilong@tjsemi.com	jiangyuan@tjsemi.com
------	-----------------------	----------------------

## 2、报告期主要业务或产品简介

### 1、主要产品及应用领域

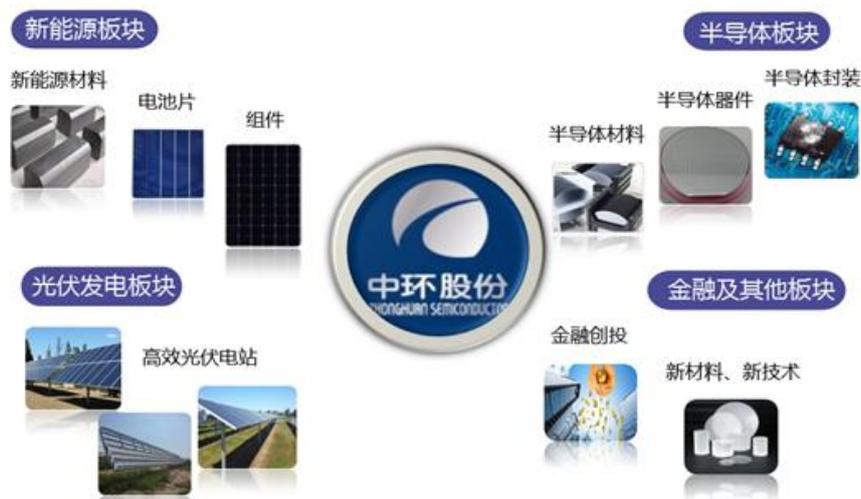
公司主要产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售；融资租赁业务；高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域，包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、航空、航天、光伏发电、工业控制等产业。

#### 公司产品应用领域



### 2、公司的主要经营模式

公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体制造和新能源制造领域延伸，形成半导体板块，包括半导体材料、半导体器件、半导体封装；新能源板块，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件。横向在强关联的其他领域扩展，围绕“绿色低碳、可持续发展”，形成光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站；金融及其他板块，包括融资租赁、新材料技术等。立足“环境友好、员工爱戴、政府尊重、客户信赖”，以市场经营为导向，通过四大业务板块，全国化产业布局、全球化商业布局，进一步实现可持续发展。



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	13,755,716,442.85	9,644,187,470.11	42.63%	6,783,335,284.24
归属于上市公司股东的净利润	632,256,816.92	584,540,813.19	8.16%	402,006,292.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,893,444.68	510,383,183.30	-38.69%	318,852,296.26
经营活动产生的现金流量净额	1,707,709,057.53	1,051,745,767.27	62.37%	819,180,674.46
基本每股收益（元/股）	0.2339	0.2211	5.79%	0.1520
稀释每股收益（元/股）	0.2339	0.2211	5.79%	0.1520
加权平均净资产收益率	5.06%	5.39%	-0.33%	3.87%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	42,697,311,470.60	31,006,595,549.44	37.70%	22,994,523,362.80
归属于上市公司股东的净资产	13,324,854,829.15	11,802,726,542.66	12.90%	10,545,696,703.33

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,801,768,459.75	3,659,476,841.54	2,794,350,888.48	4,500,120,253.08
归属于上市公司股东的净利润	124,969,637.05	175,075,561.78	125,760,987.41	206,450,630.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,886,776.16	123,375,055.35	74,768,887.36	14,862,725.81
经营活动产生的现金流量净额	262,592,748.73	277,858,144.44	319,864,307.86	847,393,856.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,032	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,159	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	27.55%	767,225,207	17,912,482			
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	9.64%	268,510,983	0			
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	3.02%	83,983,137	83,983,137			
广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	39,760,000	0			
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	38,007,000	0			
汇安基金—兴业银行—汇安基金—北方工业资产管理计划	境内非国有法人	1.03%	28,694,404	28,694,404			

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) —高毅晓峰 2 号致信基金	境内非国有法人	1.01%	28,187,000	0		
天津药业集团有限公司	国有法人	0.99%	27,548,543	0	冻结	14,828,077
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.87%	24,369,284	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.68%	19,009,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。				

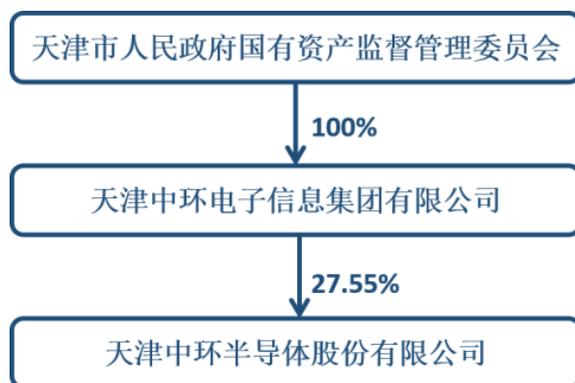
注：天津中环电子信息集团有限公司持股数量767,225,207股，其中包含2015年7月15日至2016年1月20日中环集团通过证券公司定向资产管理计划采取集中竞价方式增持股份22,100,033股。

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

## (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券	15 中环债	112265	2020 年 08 月 13 日	6,293.68	6.10%
天津中环半导体股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 中环 01	114097	2019 年 01 月 12 日	0.00	5.30%
天津中环半导体股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）	17 中环 02	114192	2018 年 07 月 18 日	0.00	6.50%
天津中环半导体股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	19 中环 01	112860	2025 年 03 月 05 日	45,000.00	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>公司于 2018 年 8 月 13 日完成“15 中环债”部分债券回售并支付了剩余托管债券 2017 年 8 月 13 日至 2018 年 8 月 12 日期间的利息，具体情况详见公司 2018 年 8 月 8 日、8 月 11 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上的《“15 中环债”2018 年付息公告》（公告编号：2018-83）、《关于“15 中环债”回售实施结果的公告》（公告编号：2018-84）。</p> <p>公司于 2018 年 1 月 12 日完成“17 中环 01”2017 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 11 日期间利息、于 2019 年 1 月 12 日完成“17 中环 01”债券回售暨本息兑付，本期债券已全部回售，并于 2019 年 1 月 12 日摘牌。</p> <p>公司于 2018 年 7 月 18 日完成“17 中环 02”债券回售暨本息兑付，本期债券已全部回售，并于 2018 年 7 月 18 日摘牌。</p>				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018 年 1 月 8 日，联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”，评级展望为“稳定”；将公司“15 中环债”债项信用等级由“AA”上调至“AA+”。具体情况详见公司 2018 年 1 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司主体及公司债券信用评级调整的公告》（公告编号：2018-03）。

2018 年 6 月 13 日，联合信用评级有限公司出具跟踪评级报告，“15 中环债”信用等级为 AA+，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，此次评级结果较上次并未发生变化。具体情况详见公司 2018 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天津中环半导体股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》。

2019 年 2 月 20 日，联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司 2019 年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2019]007 号），公司主体长期信用等级为 AA+，“19 中环 01”信用等级为 AA+。具体情况详见公司 2019 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

联合信用评级有限公司将在“15 中环债”、“19 中环 01”债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	63.17%	58.08%	5.09%
EBITDA 全部债务比	14.31%	13.69%	0.62%
利息保障倍数	1.8	1.98	-9.09%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018 年国际政治整体局势大体稳定，中美经贸摩擦给生产经营、市场预期带来不利影响。从国内角度来看，推动高质量发展、调整产能过剩和产业结构升级、新旧发展动能转换的问题依然是 2018 年经济工作的重点，同时由于生产要素配置率不高、创新能力不足，资金面整体趋紧，融资成本持续攀升，资本回报率和潜在经济增长趋缓。公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕公司“十三五”战略规划目标，加速推动各项工作的整体要求，在半导体材料及器件、新能源材料、光伏电站等产业，面对全国性的结构调整和产业转型，重整组织、再造流程、全面创新，坚持公司跨地域、跨领域、多业态、规模化、国际化、多元化发展，整合组织、兼容文化，持续创新，深化各业务板块运营能力、综合竞争力，推动公司高质量发展。

报告期内实现营业总收入 1,375,571.64 万元，较上年同期增长 42.63%，经营性现金流净额 170,770.91 万元，较上年同期增加 62.37%，含汇票的经营性现金流净额 228,669.93 万元；归属上市公司股东净利润 63,255.68 万元，较上年同期增加 8.16%；报告期末总资产为 4,269,731.15 万元，较期初增加 37.70%，归属于上市公司股东的净资产为 1,332,485.48 万元，

较期初增加 12.90%。

#### 1、半导体产业领域：

2018 年，公司紧抓半导体行业整体增长契机，利用前期技术积淀，快速推进客户认证，实现 8 英寸抛光片快速增量，天津扩产 8 英寸产线全面满产；紧抓上升期客户认证窗口，储备大量市场资源，为后期生产规模扩大储备商机。充分利用内蒙地区电力资源及产业链配套优势、天津地区现有客户及技术储备优势及无锡新项目集成的工业 4.0 理念规模化产业优势提高整体商业化竞争能力。无锡新建设产线预计 2019 年中逐步释放产能。

在半导体器件方面，公司自主研发设计印刷法 GPP 玻璃钝化芯片新工艺已实现量产，以创新工艺为核心实现产品转型升级。功率器件依靠原有的 SBD/VDMOS 产业平台，积极开发 TMBS、TrenchMOS 等产品，搭建更合理的产品结构，同时通过与中科院微电子进行产业、技术合作，打造创新产业化新项目，积极向高端半导体器件领域拓展。与国内半导体器件优秀企业扬杰科技合作，优势互补、共创下游市场，积极打造中环扬杰分立器件封装基地，以更节能环保、综合成本更低的优势推动半导体分立器件制造和封装制造的完善，进一步扩大半导体器件产品的销售与生产规模。

#### 2、新能源光伏材料产业领域：

全球光伏行业即将进入平价上网时代，落后产能将被淘汰，全球新能源材料优质产能供给紧缺，资源进一步向拥有先进产能的企业集中。

公司重点在内蒙古地区扩张光伏材料产能，四期及四期改造项目已全部达产，公司年末整体太阳能级单晶硅材料年产能合计达到 25GW 以上；通过管理优化、流程再造、精益制造向数字化、智能化转型，持续推进内蒙古地区晶体制造基地超越设计产能到 30GW；同时策划五期项目，通过项目的智慧化工厂设计及制造、组织、管理模式优化，注入光伏产品半导体化体系思维，以支撑光伏产业持续性升级，更好地满足光伏市场未来对新能源材料品质高效化、多样化的需求，持续保持全球新能源材料领域领先地位。

在江苏实施 10GW 钻石线切割超薄硅片项目已建设完成，全面进入提产达量运营期，通过工艺技术进步与精益制造增加市场供给，打造现代化智能工厂；在天津启动了钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目，通过智能管理系统、智能物流、智能仓储运及自动生产设备有机结合，打造光伏材料制造行业标杆工厂。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
新能源材料	12,039,610,164.97	1,820,692,323.99	15.12%	40.26%	-6.11%	-3.54%
半导体材料	1,012,770,279.73	304,604,191.42	30.08%	73.55%	14.65%	6.45%
半导体器件	153,305,849.04	-9,155,690.01	-5.97%	37.22%	12.90%	10.99%
电力	335,365,476.73	214,062,848.20	63.83%	63.92%	4.62%	1.05%
服务业	48,470,342.76	33,738,429.36	69.61%	-13.37%	28.98%	15.28%
其他	159,847,646.87	33,781,501.85	21.13%	52.94%	-38.21%	-15.76%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

## (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的	第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会	将原“应收票据”及“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期余额3,789,778,530.33元，上期余额2,058,091,030.19元；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列示为“其他应收款”，本期余额156,353,871.73元，上期余额100,710,820.07元；将原“固定资产”及

<p>通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。</p>	<p>第十五次会议</p>	<p>“固定资产清理”合并列示为“固定资产”，本期余额17,226,192,267.19元，上期余额11,443,586,937.08元；将原“工程物资”及“在建工程”合并列式为“在建工程”，本期余额4,578,847,890.55元，上期余额3,707,339,591.21元；将原“应付票据”及“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期余额7,749,422,931.41元，上期余额3,022,425,584.56元；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列示为“其他应付款”本期余额214,209,643.25元，上期余额512,250,799.86元；将原“长期应付款”及“专项应付款”合并列式为“长期应付款”，本期余额2,094,675,039.93元，上期余额1,909,748,013.78元；利润表中调减“管理费用”，本期419,485,024.90元，上期376,391,515.86元；单列“研发费用”，本期419,485,024.90元，上期376,391,515.86元；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报，“利息费用”，本期余额706,877,081.68元，上期余额391,788,235.62元，“利息收入”，本期余额74,683,541.37元，上期余额35,751,431.49元。</p>
--------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、新设子公司情况：天津中科环海产业园有限公司、无锡环众置业有限公司、天津环研科技有限公司、张家口环欧国际新能源科技有限公司、内蒙古中环建设管理有限公司、内蒙古中环能源发展中心（有限合伙）、内蒙古环能资源开发有限公司，以及电站类公司耿马环兴新能源有限公司、尚义县晟耀新能源开发有限公司、商丘索泰能源科技有限公司、商丘索能能源科技有限公司、商丘索光能源科技有限公司、商丘索源能源科技有限公司、商丘耀威光伏发电有限公司、金乡县昊天新能源有限公司。

2、非同一控制下企业合并情况：国电光伏有限公司。

公司 2016 年 7 月 1 日第四届董事会第四十一次会议审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨关联交易相关议案并于 7 月 4 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，2018 年 7 月 2 日，标的资产过户手续办理完毕，公司持有国电光伏 90%的股权，并于 7 月 3 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的

资产过户完成的公告》（公告编号：2018-69）。

3、名称变更：“内蒙古环欧半导体材料技术有限公司”名称变更为“内蒙古中环领先半导体材料有限公司”。

4、清算子公司情况：突泉县光晨新能源有限公司、海安环兴新能源有限公司、张北县晟耀新能源有限公司。

5、控股权发生变化，不再纳入合并范围：内蒙古中晶科技研究院有限公司、无锡中环应用材料有限公司、天津环博科技有限责任公司。

#### （4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	44.03%	至	76.04%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	18,000	至	22,000
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,496.96		
业绩变动的原因说明	<p>1.随着光伏政策调整，行业单晶化进程加速，在新的供需格局下，公司发挥单晶产品议价优势，盈利能力稳步提升。同时公司通过持续优化产品结构、集中优势客户资源，在全球光伏硅片市场实现全面领先，使得各项业务保持超预期发挥。</p> <p>2.公司通过严格成本控制、有效实施精益化管理，内部经营管理及智能制造的不断提升、优势产能的不断释放，有效降低了经营成本，持续保持盈利能力。</p>		

天津中环半导体股份有限公司

董事长：沈浩平

2019 年 3 月 28 日